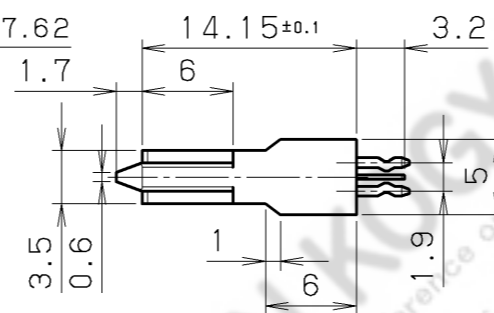
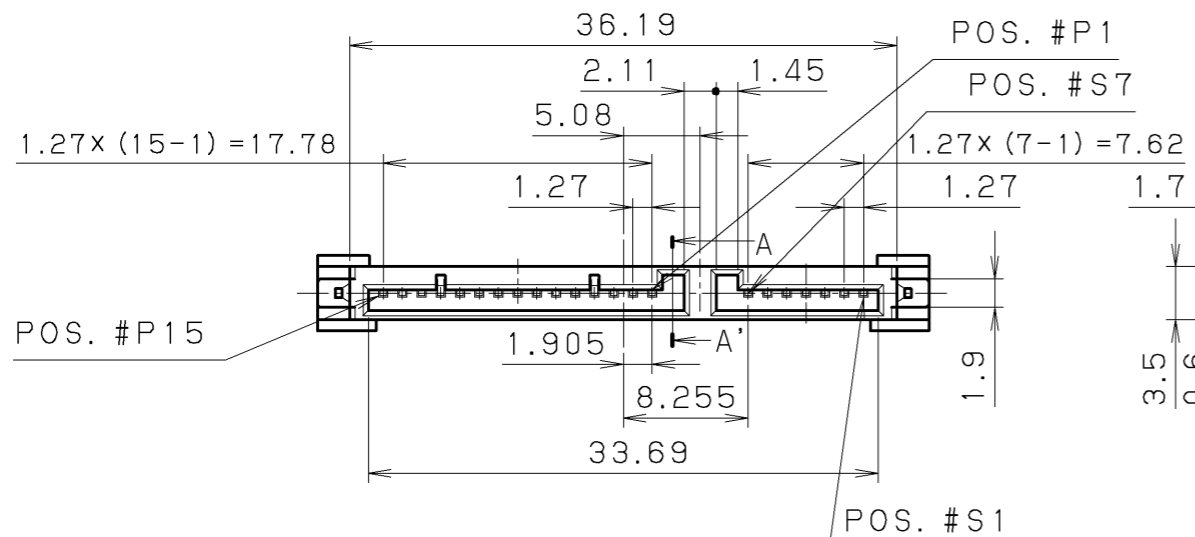


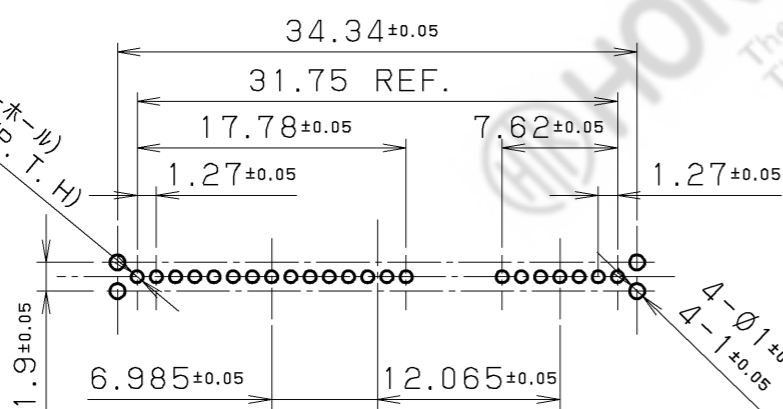
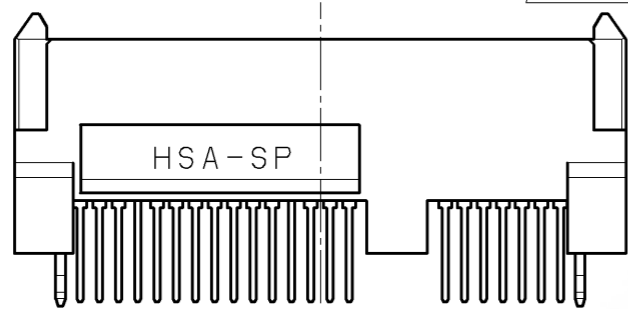
A-A' 断面
SECTION A-A'
尺度 5/1
SCALE 5:1



注1. コンタクト表面処理:
下地:ニッケルめっき 接触部:金めっき 0.2μm以上 ディップ部:錫銅めっき 2μm以上
NOTE1. CONTACT PLATING:
CONTACT AREA:GOLD 0.2μm MIN.
TERMINATION AREA:TIN/COPPER 2μm MIN.
ALL OVER NICKEL UNDERPLATED.

注2. コネクタ ピンアサイン
NOTE2. CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS

•S1 - GROUND	•P1 - 3.3V
•S2 - A+	•P2 - 3.3V
•S3 - A-	•P3 - 3.3V
•S4 - GROUND	•P4 - GROUND
•S5 - B-	•P5 - GROUND
•S6 - B+	•P6 - GROUND
•S7 - GROUND	•P7 - 5V
	•P8 - 5V
	•P9 - 5V
	•P10 - GROUND
	•P11 - GROUND
	•P12 - GROUND
	•P13 - 12V
	•P14 - 12V
	•P15 - 12V



基板参考寸法
RECOMMENDED P. C. B. LAYOUT
基板厚 t = 2.4 ± 0.15 mm
PCB THICKNESS : 2.4 ± 0.15 mm

3	ロックピン BOARD LOCK	銅合金 COPPER ALLOY	2	錫銅めっき TIN/COPPER	
2	コンタクト CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	22	注1. 参照 SEE NOTE#1	
1	絶縁体 INSULATOR	9Tナイロン PA9T	1		UL94V-0 黒 UL94V-0 BLACK

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日	DATE	尺度	SCALE	単位	UNIT	3角法			
MAR.31(2003)		2 / 1		mm (INCH)		3RD. A. P			
製 図	設 計	検 査	検 査	承認	名 称	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	名 称	シリアル ATA ストレート ホスト レセプタクル コネクタ SERIAL ATA VERTICAL HOST RECEPTACLE CONNECTOR			
M. KASHIHARA	M. KASHIHARA	K. KASAI		K. OHNISHI	製 番	HSA-SP22SFDHG			
					PART NO.	HSA-SP22SFDHG			